【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成21年9月3日(2009.9.3)

【公開番号】特開2008-50669(P2008-50669A)
【公開日】平成20年3月6日(2008.3.6)
【年通号数】公開・登録公報2008-009
【出願番号】特願2006-229608(P2006-229608)
【国際特許分類】
Ｃ２３Ｃ　4/18　(2006.01)
Ｆ１６Ｃ　33/62　(2006.01)
Ｃ２３Ｃ　4/10　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ２３Ｃ　4/18
Ｆ１６Ｃ　33/62
Ｃ２３Ｃ　4/10

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月16日(2009.7.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
次に、上記溶射層に封孔処理を施す為の有機系封孔剤として、透湿係数が１０$^{-6}$cm^3・cm/(cm^2・s・cmHg) よりも大きく、且つ、吸湿率が０．２％以上である、例えばアクリル樹脂若しくはウレタン樹脂系の封孔剤を使用した場合、この封孔剤が上記溶射層に浸透しにくくなり、絶縁抵抗値にばらつきが生じ易い。これに対し、本例の様に、上記絶縁層６ａに封孔処理を施す為の有機系封孔剤として、エポキシ樹脂若しくはフッ素樹脂系で、透湿係数が１０$^{-6}$cm^3・cm/(cm^2・s・cmHg) 以下、且つ、吸湿率が０．２％未満の封孔剤を使用すれば、この封孔剤が上記溶射層に浸透し易くなり、絶縁抵抗値のばらつきを抑えられる。尚、上記封孔剤は、セラミックスの溶射層との濡れ角度が６０度以下で、毛細管現象により含浸するものを用いる事が好ましい。又、本例の場合、セラミックスの溶射層に含まれるチタニアと、シリカと、酸化クロムとの含有量の合計を１重量％以下としている為、セラミックスの親水性を低くでき、この面からも絶縁抵抗値のばらつきを抑えられる。尚、上記含有量の合計を小さくする程、１００℃以下の飽和水蒸気未満の環境下での漏洩電流を少なくできる。この為、上記含有量の合計を、好ましくは０．５重量％以下、より好ましくは０．２重量％以下とする。
この様に、絶縁層６ａの絶縁抵抗値及び密着力のばらつきを抑えられれば、高品質な電食防止用絶縁転がり軸受を、安定して供給できる。